「114 年台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心 (TSRI-CTU Joint Research Center) 徵案計畫」重點說明

台灣半導體研究中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU)共同徵求 2025 年雙邊研究合作計畫，透過學術合作與 TSRI 之服務平台，建立團隊間長期穩定的夥伴關係，尋求雙邊科研資源與優勢共享。

(一) 執行期程：
配合台捷雙方內部作業流程，將於 2025 年 4 月 7 日確認審查獲選名單，計畫期程於同日開始（若告知獲選起始日晚於 4 月 7 日，則以該日為計畫起始日），於 8 月 15 日前安排期中報告查驗，並於 11 月 30 日前安排期末結案報告驗收，計畫截止日為 2025 年 12 月 20 日。

(二) 執行對象：
徵案團隊須為台方教授與 CTU 教授之共同合作組成，雙邊共同執行同一計畫主題，並由台方計畫主持人為申請者，在期限內提交研究計畫申請書，以進行後續評選。

(三)補助計畫內容：

1. 每件計畫補助研究經費為新臺幣壹佰玖拾萬元，將以分批付款方式給付，確認獲選後付款 50%，通過期中報告查驗付款 40%，最終通過期末結案報告驗收付款 10%。
2. 依計畫申請書之晶片下線需求規劃（如有），TSRI 將配合研究計畫實際執行進度補助每案最高新台幣貳佰萬元整之 TSRI 晶片下線額度，以支持研究團隊進行晶片實作發表。

(四)申請方式及時間：
請備齊雙邊共同撰寫之研究計畫申請書及相關補充資料，連同投標文件於投標截止期限日前送達本中心，逾期概不受理，投標截止期限地點及方式詳如招標公告，招標連結如下：
https://openinfo.narlabs.org.tw/ext/po/po_bulletin_query.php
中文標的名稱：114 年度 TSRI-CTU 聯合研究中心-雙邊學術研究計畫徵案

(五)審查評分標準：
審查評分標準：符合徵案資格且在期限內提供申請文件者，將依照雙邊連結性(30%)、實現可行性(25%)、技術前瞻創新性(20%)、應用價值性(15%)及預算規畫合理性(10%)項目進行評比。評選結果將於 4 月 7 日通知獲選團隊。如未

通過審查，原計畫書文件將不會退還申請人並不接受申覆。

(六)撥款時程：
每件計畫補助研究經費為新臺幣壹佰玖拾萬元，將以分批付款方式給付，確認獲選後付款 50%，通過期中報告查驗付款 40%，最終通過期末結案報告驗收付款 10%。研究經費的使用需建立清冊，可提供期末結案查核時備查。

(七)申請限制：
符合徵案資格且在期限內提供申請文件者。

台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心

(TSRI-CTU Joint Research Center) 徵案計畫

2025.01

本中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學 (Czech Technical University in Prague, CTU) 為促進雙方合作交流，共同成立聯合研究中心，並徵求 2025年雙邊研究合作計畫，透過學術合作與本中心之服務平台，建立團隊間長期穩定的夥伴關係，尋求雙邊科研資源與優勢共享。本案以台方計畫主持人為申請者，依本中心公布辦法與相關文件進行研究計畫案申請，其餘說明如下：

一、 計畫收件時間：公告日期起至3月14日(五)

二、 計畫期程：因配合雙方內部作業流程，將於2025年4月7日確認審查獲選名單，計畫期程於同日開始（若告知獲選起始日晚於4月7日，則以該日為計畫起始日），於8月15日前安排期中查驗，並於11月30日前安排期末查驗，計畫截止日為2025年12月20日。

三、 徵案條件：

1. 徵案團隊須為台方研究團隊與CTU教授之共同合作組成，雙邊共同執行同一計畫主題，在期限內提交雙方分工之計畫申請書，以進行後續評選。
2. 研究主題領域：
   1) 晶片設計領域：Analog Design, Digital Design, MEMS Sensors, Silicon Photonics 及其他設計領域相關主題
   2) 晶片製造領域：Semiconductor Manufacturing Technology, Technology Computer-Aided Design (TCAD) 及其他製造領域相關主題
   3) 請有意參與研究的團隊進入下方連結網址進行研究主題與聯絡資訊的填寫，以利雙邊團隊媒合：Matching List
3. 對於入選的徵案團隊，雙邊團隊之間可能需要簽訂協議，例如 CRA (Collaborative Research Agreement)。該協議可能明訂雙方權利義務分配等項目，包括有關智慧財產權的條款，協議內容將由雙邊研究團隊自行商定。
4. 依據政府採購法利益迴避原則，計畫申請人應避免擔任此計畫之評審委員。

四、 計畫補助：

1. 每件計畫補助研究經費為新臺幣壹佰玖拾萬元，將以分批付款方式給付，確認獲選後付款50%，通過期中查驗付款40%，最終通過期末結案驗收付款10%。
2. 依計畫申請書之晶片下線需求規劃（如有），TSRI將配合研究計畫實際執行進度補助每案最高新台幣貳佰萬元整之TSRI晶片下線額度，以支持研究團隊進行晶片實作

發表。

五、 申請方式：

請備齊雙邊共同撰寫之研究計畫申請書及相關補充資料，連同投標文件於投標截止期限日前送達本中心，逾期概不受理，投標截止期限地點及方式詳如招標公告，招標連結如下：

https://openinfo.narlabs.org.tw/ext/po/po_bulletin_query.php
中文標的名稱：114年度TSRI-CTU聯合研究中心-雙邊學術研究計畫徵案

六、 評定辦法：符合徵案資格且在期限內提供申請文件者，將依照雙邊連結性(30%)、實現可行性(25%)、技術前瞻創新性(20%)、應用價值性(15%)及預算規畫合理性(10%)等項目進行計劃內容及預算的評比，評選結果將於4月7日通知獲選團隊。如未通過審查，原計畫書文件將不會退還申請人。

七、 計畫期程與查驗時間點：

計畫執行期間為2025年4月7日告知獲選起始（若告知獲選起始日晚於4月7日，則以該日為計畫起始日），至12月20日為計畫截止日。此計劃共包含兩次查驗，分為期中查驗及期末結案查驗。

1. 期中查核點：於8月15日前提交期中進度執行報告書及計畫時程進度檢核表，期中進度執行報告書內容應包含目前實際執行計畫內容、已完成之工作項目及未完成事項之期程等，並至少完成1項執行績效量化指標。

2. 期末結案查核：於11月30日前完成研究計畫書內之規劃項目並提交期末結案報告書及計畫時程進度檢核表，期末結案報告內容包含雙邊研究報告說明、雙邊短期交流紀錄與心得、學術論文或專利申請證明等執行績效成果說明。

八、 注意事項：

1. 研究計畫申請書的結構如下：

1) 基本資料（計畫主題與分類、雙邊團隊主持人及聯繫窗口資訊）
2) 團隊成員（雙邊團隊協作人員學歷、職掌與分工）
3) 計畫摘要
4) 計畫內容（計畫背景、技術優勢、研究實施策略、預期成果及國際研究合作之價值貢獻等）
5) 計畫時程規劃（工作時程控管、查核點說明、預計完成項目及績效項目說明）
6) 預算規劃
7) 雙邊聲明與簽名
8) 附件

2. 此計畫研究經費的使用需建立清冊，可提供期末結案查核時備查。

3. 重要作業時程：

開放申請	2025年2月10日(三) (若公告日晚於2月10日，則以公告日為申請起始日)
截止日期	2025年3月14日(三)
計畫起始日	2025年4月7日(一)

	(若告知獲選起始日晚於4月7日，則以該日為計畫起始日)
期中查驗	2025年8月15日前提供查驗報告
期末驗收	2025年11月30日前提供結案報告

九、 聯繫窗口：

聯絡電話：03-5773693 #7713(詹小姐) #7170(江小姐)

E-mail：tsri.ctu_jrc@narlabs.org.tw

十、招標公告資訊：

招標公告網址如下

https://openinfo.narlabs.org.tw/ext/po/po_bulletin_query.php

中文標的名稱：114年度TSRI-CTU聯合研究中心-雙邊學術研究計畫徵案